

SJ

中华人民共和国电子行业军用标准

FL 5980

SJ 50033/113—96

半导体光电子器件
GD3252Y 型光电二极管
详细规范

Semiconductor optoelectronic devices

Detail specification for

type GD3252Y photodiodes

1996-08-30 发布

1997-01-01 实施

中华人民共和国电子工业部 批准

半导体光电子器件
GD3252Y 型光电二极管详细规范

SJ 50033/113-96

Semiconductor optoelectronic devices
Detail specification for type GD3252Y photodiodes

1 范围

1.1 主题内容

本规范规定了 GD 3252Y 型光电二极管(以下简称器件)的详细要求。

1.2 适用范围

本规范适用于器件的研制、生产和采购。

1.3 分类

1.3.1 器件等级

本规范所提供的器件保证等级按 GJB 33《半导体分立器件总规范》的规定,从低到高分为普军级(GP)和特军级(GT)两级。

2 引用文件

GB 11499-89	半导体分立器件文字符号
GJB 33-85	半导体分立器件总规范
GJB 128-86	半导体分立器件试验方法
GJB 597-88	微电路总规范
SJ 2354-83	PIN、雪崩光电二极管测试方法
SJ/Z 9014.2-87	半导体器件 分立器件和集成电路第 5 部分 光电子器件

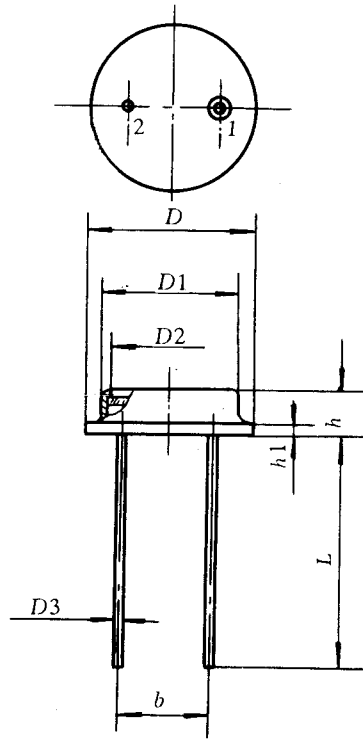
3 要求

3.1 详细要求

各条要求应符合 GJB 33 和本规范的规定。

3.2 设计、结构和外形尺寸

器件的设计、结构和外形尺寸应符合 GJB 33 和本规范的规定,芯片结构为 PIN,也可按合同的要求提供不同于图 1 规定的外形尺寸(见 6.2 条)。



mm		
尺寸符号	最小值	最大值
D	13.5	14.5
$D1$	12.0	12.4
$D2$	9.8	10.2
$D3$	0.4	0.6
b	7.62(标称值)	
h	3.6	4.2
$h1$	0.6	0.8
L	20	-

图 1 外形尺寸

3.2.1 器件芯片材料

芯片材料为硅。

3.2.2 引出端排列

管脚	1	2
接线	正极	负极(接外壳)

3.2.3 封装形式

全密封金属管壳平面玻璃窗口。

3.2.4 引线长度

可按合同的要求(见 6.2 条)提供引线长度不同于图 1 规定的器件。

3.3 引线材料及涂层

引线材料可为钨合金,引线涂层应镀金。也可按合同要求(见 6.2 条)选择涂层。

3.4 最大额定值和主要光电特性

3.4.1 最大额定值